# 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 关于新增银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况概述

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")《关于预计 2023 年银行综合授信的议案》《关于公司新增银行综合授信的议案》分别经公司 2022 年第五次临时股东大会、第三届董事会第十二次会议审议通过, 随着公司业务规 模的进一步扩大,流动资金需求增加,为满足公司经营发展需求,公司拟调整部 分银行预计的综合授信额度,期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后1年 内,授信期限内,授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等业务。综合授信额度并非公司实际融 资金额,公司将根据实际经营需求,在额度范围内办理各项融资业务,具体融资 金额以公司与银行签署的融资协议为准。具体如下:

授信银行名称:中国民生银行股份有限公司苏州分行

原授信额度:不超过 7,500.00 万元人民币

调整后授信额度: 不超过 22,500.00 万元人民币

担保方式: 专利权质押

以下专利可用于质押:

发明名称	专利号
反光焊带及太阳能组件	ZL 2015 1 0366155.1
快速涂锡机	ZL 2016 1 0333082.0
黑色汇流条的高光不沾锡涂层及黑色汇流条的制备方法	ZL 2021 1 1519581.6

在授信有效期内,公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额 度内办理公司的融资事宜,并签署有关与各家银行发生业务往来的法律文件,除 相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外,董事会不再另行召开会 议审议。

## 二、审议和表决情况

2023 年 7 月 5 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议表决通过了《关于新增银行综合授信的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

## 三、对公司的影响

本次新增银行综合授信符合公司实际发展需求,有助于改善公司当前现金流量及财务状况,有助于公司与光伏行业保持同步高速发展,对提升公司业务规模、综合竞争力等方面具有积极影响。

#### 四、备查文件

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月5日